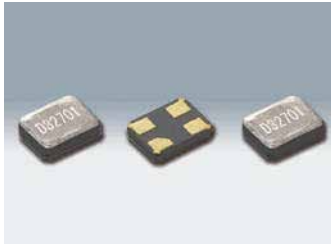


表面贴装型晶体谐振器/MHz带晶体谐振器

DSX1612S

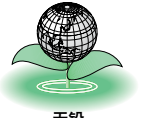


DSX1612S

实际尺寸 □

■ 优点

- 1612尺寸、厚度0.35mm、超小型·超薄型·超轻量SMD晶体谐振器: DSX1612S
- 高精度、高可靠性(还可以支持面向通信用途的长期老化为 $\pm 1 \times 10^{-6}$ /年、 $\pm 3 \times 10^{-6}$ /5年的产品)
- 可实现高密度贴装
- 无需防湿包装管理
Moisture Sensitivity Level: LEVEL1 (IPC/JEDEC J-STD-033)



■ 用途

- 移动通信设备、近距离无线模块、数字AV设备、PC等新一代小型设备
- 可穿戴设备

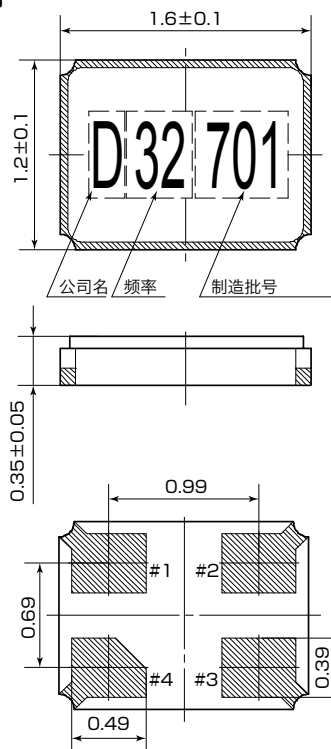
■ 一般规格

项目 \ 型号	DSX1612S		
频率范围	24 ~ 32MHz	32 ~ 40MHz	40 ~ 54MHz
谐波次数	Fundamental		
负载电容	8pF, 10pF, 12pF		
激励电平	10 μ W (100 μ W max.)		
频率公差	$\pm 20 \times 10^{-6}$ (at 25°C)		
串联电阻	200 Ω max.	150 Ω max.	100 Ω max.
频率温度特性	$\pm 30 \times 10^{-6}$ / -30 ~ +85°C (Ref. To 25°C)		
保存温度范围	-40 ~ +85°C		
包装单位	3000pcs./reel (ϕ 180)		

有关其他规格或者特殊规格请咨询营业部门。

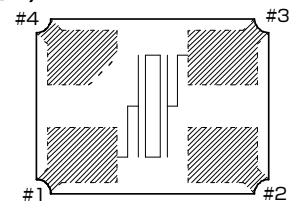
[mm]

■ 外形尺寸



■ 内部连接

<Top View>



- #1、3为晶体端子
- #2与防护罩连接
- #4为开放 (未连接)
- #2、4推荐与GND连接

■ 焊盘图形(参考)

<Top View>

